

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 10 月 20 日(20.10.2011)

PCT

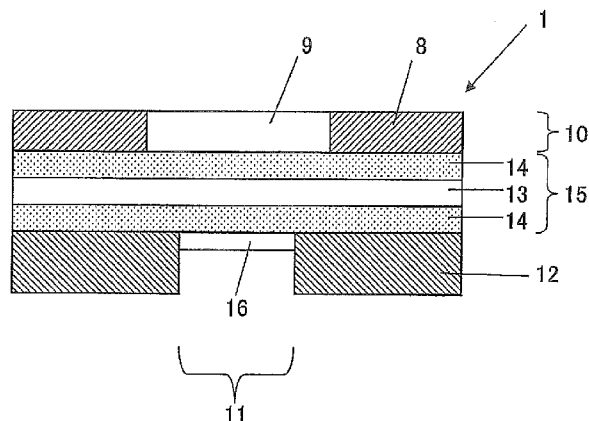
(10) 国際公開番号
WO 2011/129254 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) *B24B 37/00* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/058778
- (22) 国際出願日: 2011 年 4 月 7 日(07.04.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-094318 2010 年 4 月 15 日(15.04.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社 (TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 木村 毅 (KIMURA, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 1 7 番 1 8 号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3-9 新大阪MTビル 1 号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド

[図3]



(57) **Abstract:** Disclosed is a polishing pad (1), which can detect an optical end point with high accuracy when polishing is being performed, and which can prevent a slurry from leaking from the polishing layer (10) side to the cushion layer (12) side, even in the case wherein the polishing pad has been used for a long period of time. Also disclosed is a method for manufacturing a semiconductor device using the polishing pad. In the polishing pad, the polishing layer, which has a polishing region (8) and a light transmitting region (9), and the cushion layer, which has a through hole (11), are laminated with a double-sided adhesive sheet (15) therebetween such that the light transmitting region and the through hole overlap each other. A translucent member (16) is bonded to the adhesive layer (14) of the double-sided adhesive sheet in the through hole.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2011/129254 A1



本発明は、研磨を行っている状態で高精度の光学終点検知を可能とし、長期間使用した場合であっても研磨層（１０）側からクッション層（１２）側へのスラリー漏れを防止することができる研磨パッド（１）を提供することを目的とする。また、該研磨パッドを用いた半導体デバイスの製造方法を提供することを目的とする。本発明の研磨パッドは、研磨領域（８）及び光透過領域（９）を有する研磨層と貫通孔（１１）を有するクッション層とが、前記光透過領域と前記貫通孔とが重なるように両面接着シート（１５）を介して積層されており、前記貫通孔内の両面接着シートの接着剤層（１４）に透光部材（１６）が貼付されていることを特徴とする。